

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2023-019

深圳华大智造科技股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及全资或控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关增信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，具体融资的种类、金额、利率、融资期限等以签署的具体合同为准。

授信额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议通过之日，授信额度在有效期内可以滚动使用。

为提高效率，公司董事会同意授权公司总经理或其授权人士代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日